



2026 年 3 月 27 日

各 位

会 社 名	ローム株式会社
代表者名	代表取締役社長 社長執行役員 東 克己 (コード：6963、東証プライム市場)
問合せ先責任者	広報 IR 部 統括課長 後藤 辰英 (TEL. 075-311-2121)

**東芝デバイス&ストレージ株式会社の半導体事業及び
三菱電機株式会社のパワーデバイス事業との事業・経営統合に関する協議開始に向けた
基本合意書の締結に関するお知らせ**

ローム株式会社（以下、「当社」）は、株式会社東芝（以下、「東芝」）、日本産業パートナーズ株式会社（以下、「JIP」）及び TBJ ホールディングス株式会社（以下、「TBJ HD」、JIP と併せて「JIP ら」と表記）並びに三菱電機株式会社（以下、「三菱電機」当社、東芝及び JIP らと併せて「本件当事者」と表記）との間で、当社と東芝の子会社である東芝デバイス&ストレージ株式会社（以下、「東芝デバイス&ストレージ」）の半導体事業（以下、「本対象事業（東芝）」）との統合（以下、「本事業統合（東芝）」）に向けて、当社、東芝及び JIP らの間で本格的に協議・検討を開始すること、並びに、当社、本対象事業（東芝）及び三菱電機のそれぞれのパワーデバイス事業の事業・経営統合（以下、「本事業統合（三菱）」、本事業統合（東芝）と併せて「本件取引」と表記、三菱電機のパワーデバイス事業を「本対象事業（三菱）」）に向けて三菱電機が当該協議に加わることで、本件取引が世界市場で競争し得る事業規模や技術基盤を実現し、もって、我が国の半導体事業として幅広い顧客層と広範な産業分野の発展に大きく貢献するものであり、統合事業体の事業価値の最大化を実現し得るものであるという考えから合意し、本日付で基本合意書（以下、「本基本合意」）を締結いたしましたので、お知らせいたします。

当社と東芝デバイス&ストレージの本対象事業（東芝）との間の提携については、2024 年 3 月 29 日付「東芝 半導体事業との業務提携強化に向けた協議開始の提案について」にてお知らせしておりました、協議開始の提案から本日に至るまで、当社、東芝及び JIP らの間で協議を続けてまいりました。これは、将来の成長に向け、国際競争力を一層強化するための施策の一つとして、半導体市況や事業環境を見極めながら慎重に議論を進めてきたものです。今般、本事業統合（東芝）に係る法的拘束力のある最終契約書（以下、「最終契約書（東芝）」）の締結に向けてのデュー・ディリジェンス及び統合事業体の事業価値の最大化を目指した具体的なシナジー協議に進むことについて合意し、基本合意書の締結を協議しておりましたが、本協議に三菱電機が加わることとなりました。本事業統合（三菱）に関する協議・検討は、本日時点では、その緒に就いたばかりの状況であり、今後新たに開示すべき事項が発生した場合には、速やかに開示するようにいたします。

なお、本事業統合（東芝）に関する最終契約書（東芝）の締結は、本件当事者の間で引き続き協議の上でデュー・ディリジェンスの実施後速やかに決定する予定であり、最終契約書（東芝）を締結した場合には、その内容について改めて開示する予定です。また、本件取引の実施は競争法その他の法令等に基づき必要なクリアランス・許認可等の取得が完了することが前提となります。

記

1. 本件取引の概要

(1) 本事業統合（東芝）に係る取引スキーム

本事業統合（東芝）のスキーム及びその具体的な内容に関しては、本日以降、当社、東芝及び JIP らの間で誠実に協議し、最終契約書（東芝）の締結時までに決定する予定です。決定次第、速やかにお知らせいたします。

(2) 本対象事業（東芝）の概要

東芝デバイス&ストレージの半導体事業

(3) 本事業統合（東芝）の日程

本基本合意締結日	2026 年 3 月 27 日（本日）
最終契約書（東芝）締結日	デュー・ディリジェンスの実施後 速やかに
本事業統合（東芝）の効力発生日	未定

（注） 上記は現時点での予定であり、本件当事者の今後の協議により変更する場合があります。

(4) 本事業統合（三菱）に係る取引スキーム、日程等

本事業統合（三菱）後の最終形態としては、当社、東芝デバイス&ストレージ及び三菱電機のそれぞれのパワーデバイス事業を統合した事業体を設立することを想定しておりますが、その詳細なスキームについては現時点では未定でございます。最終的な本事業統合（三菱）のスキーム及びその具体的な内容に関しては、本日以降、本件当事者の間で誠実に協議し、本事業統合（三菱）に係る法的拘束力のある最終契約書（以下、「最終契約書（三菱）」）の締結時までに決定する予定です。決定次第、速やかにお知らせいたします。

(5) 取引対価

本件取引に係る対価につきましては、現時点で確定しておりません。今後実施するデュー・ディリジェンス及び第三者算定機関による本対象事業（東芝）及び本対象事業（三菱）の価値算定結果等を踏まえ、取引条件が妥当かつ公正であるか、また当社の株主価値向上に資するものであるか等の観点から、慎重に協議・検討の上、最終契約書（東芝）及び最終契約書（三菱）の締結時までにそれぞれ決定する予定です。決定次第、速やかにお知らせいたします。

2. 本事業統合（東芝）の相手先の概要

(1) 名 称	東芝デバイス&ストレージ株式会社	
(2) 所 在 地	神奈川県川崎市幸区小向東芝町 1 番地	
(3) 代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名	代表取締役社長 牛島 知巳	
(4) 事 業 内 容	半導体事業、ストレージプロダクツ事業	
(5) 資 本 金	10,000 百万円	
(6) 設 立 年 月 日	2017 年 7 月 1 日（事業承継日）	
(7) 大 株 主 及 び 持 株 比 率	株式会社東芝	100.0%
(8) 上場会社と当該会社の関係	記載すべき資本関係はありません。 なお、当社は、当該会社の完全親会社である東芝の完全親会社である TBJH 株式会社の完全親会社である TBJ HD の発行済普通株式を所有する TB 投資事業有限責任組合に対して 1,000 億円の出資を行って	

	おります。 また、当社は、TBJ HD の発行する無議決権優先株式の引受けを行い、2,000 億円の出資を行っていましたが、本日時点でそのうち1,650 億円の償還を受けております。
人 的 関 係	該当事項はありません。
取 引 関 係	当社と当該会社との間には、製品またはサービス等の取引関係があります。
関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	該当事項はありません。

3. 本事業統合（三菱）の相手先の概要

(1)	名	称	三菱電機株式会社	
(2)	所	在	地	東京都千代田区丸の内二丁目7番3号
(3)	代表者の役職・氏名		代表執行役 執行役社長 漆間 啓	
(4)	事業内容		各種電気機械器具、電子応用機械器具、家庭用電気機械器具、半導体素子、集積回路その他一般機械器具及び部品の製造並びに販売	
(5)	資本金		175,820百万円	
(6)	設立年月日		1921年1月15日	
(7)	大株主及び持株比率		日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	15.36%
			株式会社日本カストディ銀行（信託口）	5.53%
			STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部）	4.70%
			明治安田生命保険相互会社	3.99%
			STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部）	2.40%
			JP MORGAN CHASE BANK 385632（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部）	2.28%
			三菱電機グループ社員持株会	2.10%
			STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部）	2.00%
			日本生命保険相互会社	1.77%
			JP MORGAN CHASE BANK 380055（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部）	1.71%
(8)	上場会社と当該会社の関係			
資本関係		記載すべき資本関係はありません。		
人的関係		該当事項はありません。		
取引関係		当社と当該会社との間には、製品またはサービス等の取引関係があります。		
関連当事者への該当状況		該当事項はありません。		

（注）「大株主及び持株比率（2025 年 9 月 30 日現在）」は、三菱電機が 2025 年 11 月 11 日に提出した 2026 年 3 月期（第 155 期）に係る半期報告書の「大株主の状況」より引用しています。

4. 業績への影響

本件取引が当社の 2026 年 3 月期連結業績に与える影響は軽微であると見込んでおりますが、今後の進展によって公表すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

5. 中期経営計画への影響

本件取引は基本合意段階であり、その実行可否・条件等は今後の協議により決定されますが、現時点において、中期経営計画を変更することは決定しておりません。なお、最終契約書（東芝）及び最終契約書（三菱）の締結に至った場合には、見直しを行う可能性があります。今後の進展によって公表すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

以 上